

GZ02Z031921M

Österreichische

Betriebs Technik

P.b.b.
Aufgabepostamt:
1010 Wien
Erscheinungsort,
Verlagspostamt:
1010 Wien

Das Magazin für Führungskräfte

10 - 2006

Lach Diamant:

Neuentwicklungen

Von Lach Diamant ist ein neuer Katalog mit allen Neuentwicklungen zum Ritzten, Trennen, Fräsen und Sägen für eine Kosten senkende Bearbeitung aller bestückten und unbestückten Leiterplatten-Materialien wie PCB, Alu, Cu und StaRflex erschienen.

Neu ist vor allem das vielfältige Angebot der Diamant- und HM-Nutzentrenner, Diamant-Kerbritzfräser für Alu, Cu und StaRflex, Diamant-Eckenabrundfräser, Diamant-Trennfräser für Trennen des Reststeges an Multilayer, Diamant-Oberfräser zum Tiefenfräsen von Leiterplatten und Diamant-Senkfräser zum Entfernen der Kupferfolie an Multilayer-Platten.

Der neue Katalog kann über office@lach-diamant.de angefordert werden.

